

WS 22, ein Trenngerät nach dem Läppverfahren, geeignet für das Trennen delikater Proben. Das Gerät arbeitet mit minimalem Kerbverlust und erzeugt zerstörungsarme Oberflächen.

WS 22, works by the lapping method, it is ideal for cutting small samples. The curf loss ranges from 60µm to 80µm. The damage caused during cutting is very low in comparison to saws using diamond coated wires.

EINSATZGEBIETE

- * Probenpräparation in SEM und TEM
- * Fehleranalyse an Bauelementen
- * Untersuchungen an Einkristallen
- * Einsatz anstelle von Funkenerosion
- * Untersuchungen in der Dentaltechnik
- * Spröde Materialien mit Spaltebenen
- * Optische Fenster
- * Halbleiter

FIELDS OF USE

- * sample preparation in SEM and TEM
- * fault analysis
- * cutting single crystals
- * use instead of spark erosion
- * use in dental research
- * brittle materials with cleavage planes
- * optical windows
- * semiconductors



WIRE-SAW, Typ WS 22

SPEZIFIKATION

- * schweres Maschinengestell, 60 kg
- * Bewegungsablauf ähnlich einer Gattersäge
- * Trägerdraht aus Wolfram, unbeschichtet
- * Läppmittelzuführung automatisch
- * Oszillationsfrequenz 300 oder 400/min.
- * Probenschwenkeinrichtung
- * Probenführung während des Trennens
- * minimale Kerbverluste 80 - 100µm
- * Oberflächengüte „wie geläppt“

TECHNICAL DETAILS

- * heavy steel base, weight app. 60 kg
- * works like a frame saw
- * the carrier wire consists of plane tungsten
- * slurry feed: fully automatic
- * oscillation frequency: settable 300 or 400/min
- * sample tilt facility
- * wire guiding during cut
- * curve loss in the range of 70 to 90µm
- * surface quality after cutting: as lapped